

第39回 エレクトロニクス実装学会 春季講演大会

◆チュートリアル講演 6件 3月11日(火)

チュートリアル講演 テーマ名	講演者名	所属
電子回路実装技術の役割、将来と人材	羽深 等 氏	国立大学法人 横浜国立大学
変化し続けるプリント配線板、ガラスコアサブストレート	八甫谷 明彦 氏	よこはま高度実装技術コンソーシアム
電子機器の高機能化、応用拡大で、半導体・配線板構造が変わる！ － 電子機器実装の狙うべき方向を探る －	本多 進 氏	よこはま高度実装技術コンソーシアム
電子部品の現在地：Society5.0時代のセンサ～IoTから人間拡張まで～	谷本 琢磨 氏	AKKODiSコンサルティング株式会社
光電子集積化技術の動向と課題	竹村 浩一 氏	アイオーコア株式会社
SiCはパワーデバイス主要基板としての地位を確立したか？	宮代 文夫 氏	よこはま高度実装技術コンソーシアム